

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	天弘基金（陈祥）、博时基金（胡康）、交银基金（何雄）、国泰基金（谢泓材）、中银基金（时文博）、鑫元基金（翁嘉敏、张咏）、华商基金（张狄龙）、诺安基金（黄友文）、兴业基金（颜格）、中加基金（黄翱）、兴银基金（凌展翅）、信达澳亚基金（杨珂）、光大保德信基金（朱祖跃）、东吴基金（边梦蕤）、信诚基金（王帅）、高腾基金（吕栋）、海富通（陈华鑫）、博普资产（刘世昌）、润晖投资（王伟）、广州云禧私募（李伟杰）、光大证券（黄帅斌、桑德昕、徐向炜、叶小舟）、方正证券（赵璐、郝润祺）、平安证券（郑源）等，合计约 31 名机构和个人投资者。
时间	2026 年 6 月 17 日（星期三）13:30 至 15:00
地点	劲拓光电产业园（深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 胡毅先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书介绍公司基本情况</p> <p>（一）公司简介</p> <p>公司成立于 1997 年，2014 年在深交所创业板上市（股票代码 300400），是一家集研发、生产、销售和服务于一体的电子热工装备制造行业龙头企业，产品广泛应用于消费电子、通讯电子、汽车电子、家电电子、航空航天电子、机器人电子元件等领域的精密制造。</p> <p>（二）公司从事的主要业务</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"></div> <p style="text-align: center;">图：公司电子制造专用设备的部分应用领域</p> <p>公司电子装联设备覆盖电子 PCBA 生产过程中的焊接、检测等多个流程，以“电子热工设</p>

备+AOI 和 SPI 检测设备+自动化设备”为下游电子制造领域客户提供一站式服务和整套零缺陷焊接检测制造系统；作为国内电子热工领域龙头企业，公司在电子热工领域具有领先的技术优势、扎实的制造能力和完善的配套服务体系，回流焊设备全球市场份额居前、系国家制造业单项冠军产品。上市 12 年以来，公司持续盈利，技术驱动是穿越周期的核心，公司近年来持续加大研发投入，形成对底层技术的深刻理解，构建公司独特的竞争力。



图：零缺陷焊接检测制造系统示意图

（三）公司的经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 78,513.89 万元，较上年同期增长 7.74%；其中：电子装联设备业务实现营业收入 72,696.19 万元，占营业总收入的 92.59%，较上年同期增长 13.97%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,397.85 万元，较上年同期增长 0.97%；经营性现金净流入 25,629.92 万元，较上年同期增长 108.99%。

2026 年第一季度，公司实现营业总收入 16,881.80 万元，较上年同期增长 9.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,559.93 万元，较上年同期增长 3.40%。

公司 2025 年度及 2026 年第一季度具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》和《2026 年一季度报告》。

投资者关系活动
主要内容介绍

二、问答交流

1、公司未来业务发展的重点方向是什么？

回复：公司将继续聚焦热工装备的核心主业，加大研发投入，推进产品智能化、高端化升级；另外，公司也正在加大海外市场开拓，持续构建海外市场服务能力。

2、公司近几年进行了哪些研发投入？

回复：公司自 2023 年调整核心经营战略，深刻践行“技术导向”的发展思想。在此基础上，以超大尺寸集成电路专用回流焊设备项目和智能回流焊项目的技术需求为指引，公司开展了大量基础性、前沿性的工作，如材料研究、热仿真、对流仿真等，同时与合作伙伴联合开发了大尺寸芯片焊接热形变测试系统，这些工作支撑了公司在焊接设备硬件设计及工艺设计开展开拓性创新性研究；另外公司分级重构了热工装备核心功能模块的设计，并对热工设备进行数字仿

真建模，在此基础上开展设备软件系统智能模型训练，并正在逐步实现智能节能、智能维护保养、智能工艺转换等热工设备核心智能化功能的落地。

3、如何看待劲拓股份在电子热工设备行业中的竞争优势？

回复：在热工焊接设备领域，劲拓股份拥有全行业最完善的产品图谱，累计服务了全球 150+ 个地区的近 7000 家客户；同时公司凭借良好的供应链管控和售后服务体系，在行业树立良好的市场口碑和品牌形象；公司已多年牢牢占据电子热工装备行业的龙头地位。公司自 2023 年核心战略从“业务导向”转型为“技术导向”后，研发工作转变为驱动公司产业竞争力提升的核心引擎。在与客户联合前沿技术攻关过程中，将建立多年的合作关系从传统的买卖对接深化为紧密的研发创新共同体，同时部分理论研究工作借助与高校的协同创新机制，提升了技术成果的转化与迭代的效率。在与客户合作的双向赋能过程，劲拓股份正稳步向“行业前沿技术新工艺新标准制定者”的目标前行，并在产学研用一体化的生态中，持续推动热工装备领域的技术边界拓展与产业升级。

4、目前大尺寸芯片 PCBA 焊接中遇到的技术难题有哪些？

回复：当前，芯片算力逐年提升，芯片尺寸大型化，及电路板结构复杂度提升，已成为产业趋势。原有的传热机制，使得大尺寸芯片区域 PCBA 焊接加热时热量从芯片边缘向中间传递过程中，边缘和中心区域出现较大温差。因为材料热膨胀系数的差异，这种因为 PCBA 焊接升温 and 降温过程所带来的温差，会导致芯片和 PCB 出现不同步弯曲，最终在芯片焊接区域带来如虚焊、开路、微裂纹、短路等焊接缺陷，严重影响焊接品质，并导致经济损失。业界就此问题，从材料选型、焊接工艺优化等方面正在进行深刻的技术探索。当前，劲拓股份致力于通过设计全新的热工焊接设备为客户提供精准控温性能与复杂焊接工艺适配能力，并满足更多芯片先进封装工艺选型和材料选型的焊接技术要求。

5、目前公司大尺寸芯片焊接设备项目进度怎么样？

回复：目前自研的超大尺寸集成电路专用回流焊设备，已经迭代至第五代产品，专注于应对先进封装芯片在 PCBA 焊接时的复杂工艺技术难题。目前公司已将超大尺寸集成电路专用回流焊设备送至客户场域现场，开展样机性能测试。

6、公司为什么要开发智能回流焊这款产品，当前项目怎么进度？

回复：PCBA 热工焊接环节产品的稳定生产，需要有经验操作人员对生产设备进行规范性保养和维护。但随着 PCBA 焊接产品的价值量提升，以及公司走向海外配合海外工厂产能建设，在这些新的需求中，为了减少操作人员设备保障能力的波动对设备稳定持续运行的影响，劲拓

投资者关系活动
主要内容介绍

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>股份 2023 年提出热工装备三大智能功能，并于 2024 年正式对外发布智能回流焊样机，获得了客户的积极反馈。公司已于 2025 年三季度，率先将行业首台智能回流焊设备运至客户现场先后进行了离线测试和在线测试，可获取的半年运行数据显示节能节氮等经济效果明显，并在该样机测试过程中与客户共同定义并探索下一代设备的智能演进方向。公司目标 2026 年内实现智能回流焊形成量产销售。</p> <p>7、公司产品使用寿命怎么样？</p> <p>回复：正常来说，设备都可以按照 5—10 年折旧来作为使用期限。但因为 SMT 环节多、细分领域技术变化快，所以下游客户会根据实际技术需求做设备的更新调整，我们也会配合客户做新产品开发，设备更换的寿命就没有严格的规定。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 6 月 17 日</p>